



Fully Automatic Die Separator DDS2310

对应小晶粒晶圆分割的晶粒扩片机

实现隐形切割后的小晶粒稳定分割

以隐形切割在晶圆内部改质层，针对其高品质晶粒实现了分割。
有效对应小晶粒的隐形镭射应用。

切割道变宽，维持均等

搭载针对小晶粒分割而开发的热扩工作盘及FIR加热机，使小晶粒可保持足够的切割道。
※FIR(Far Infrared)...远红外线

标准搭载FIR加热机×4，提升生产性能

因搭载4台FIR加热器，而提升胶带收缩性能，实现小晶粒分割的UPH提升。



冷扩展提升DAF分割品质

因采用冷扩展方式，可使DAF安定分割。不仅是小晶粒分割，也可适用DAF分割的应用。

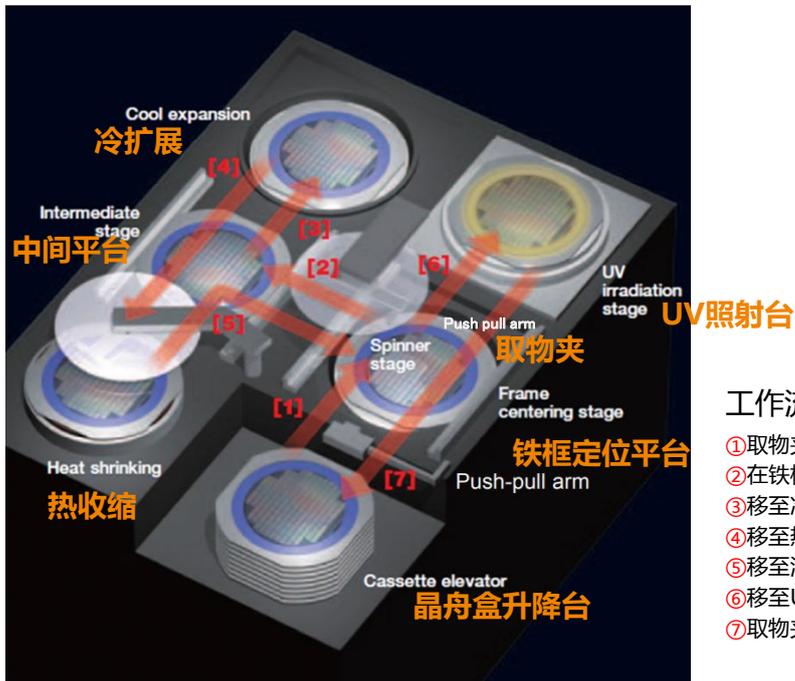
利用胶带铁框(Tape Frame)搬送，平顺地进入下一制程

热收缩可消除扩展后在切割胶带外围所产生的松弛。由此可免去更换胶带的步骤，可直接将胶带铁框(tape frame)送往下一个上片制程(die bonding process)

■适用的应用例

- 隐形切割后的晶粒分割
- DBG/SDBG后的DAF分割
- 刀片切割后的DAF分割

Fully Automatic Die Separator DDS2310



工作流程系统

- ① 取物夹将工作物从晶舟盒取出，送往铁框定位平台→
- ② 在铁框定位平台进行定位后，送往中间平台→
- ③ 移至冷扩展台上，进行冷扩展→
- ④ 移至热扩展台上，再进行扩展·热收缩→
- ⑤ 移至清洗台上，进行清洗·干燥→
- ⑥ 移至UV照射台上，进行UV照射→
- ⑦ 取物夹将工作物收回晶舟盒内

规格

Specification		Unit		
Workpiece size		mm	ø300	
Cooler expansion stage	Temperature setting range	°C	0	-5
			Fixed	Setting when shipped from the plant
	Max. push-up amount	mm	30	
	Push-up amount setting	mm	0 - 30 (step: 0.001)	
	Max. push-up speed	mm/s	400	
	Push-up speed setting	mm/s	0.001 - 400 (step: 0.001)	
Heat shrink stage	Hot air temperature	°C	200 or 220 or 250	
	Max. push-up amount	mm	20	
	Push-up amount setting	mm	0 - 20 (step: 0.001)	
	Max. push-up speed	mm/s	50	
	Push-up speed setting	mm/s	0.001 - 50 (step: 0.001)	
Machine dimensions (W x D x H)		mm	1,200 x 1,550 x 1,800	
Machine weight		kg	Approx. 900	

■使用条件

- 请使用大气压露点-15℃以下，残留油分为0.1 ppm，过滤度0.01 μm/99.5%以上的洁净压缩空气。
- 请将放置机械设备的实验室室温设定在20℃~25℃之间，便将波动范围控制在±1℃以内。
- 请将切削水的水温控制为室温±4℃。
- 其他，请避免设备受到撞击及外界的可感震动。另外，请勿将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油污的装置附近。
- 本装置会使用到水，因对应可能会发生漏水现象，请将本装置安装在有防水性的地板及有排水处理的场所，※为改良设备，本公司可能在预先不通知用户的情况下就本规格实施变更，因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司业务部联络。